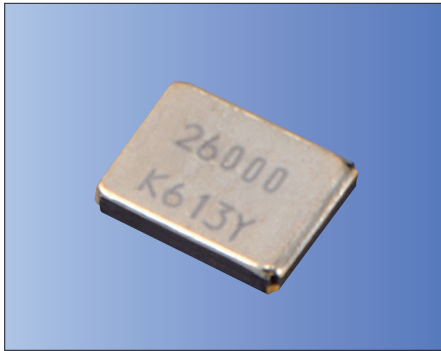


表面贴装型 CX2016DB (消费类电子产品应用/ 移动通信应用)

2.0×1.6mm



RoHS指令对应产品

■特点

- 消费类电子产品应用·移动通信应用晶体谐振器
- 小型、薄型(2.0×1.6×0.40mm)
- 陶瓷封装
- 可对应回流焊

■用途

- 数字家电
- 消费类电子产品
- 移动通信、Bluetooth®、无线LAN

※Bluetooth®是Bluetooth SIG Inc.(美国蓝牙公司)的注册商标。

■型号表示方法

CX2016DB 27000 D0 G □ J CC
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①系列名称

②频率

③负载容量

④频率容差
(常温偏差)

D0 8 pF

G ±15×10⁻⁶

⑤工作温度范围以及⑥频率温度特性

| | | |
|----|-------------|----------------------|
| EJ | -10 ~ +70°C | ±15×10 ⁻⁶ |
| LN | -30 ~ +85°C | ±25×10 ⁻⁶ |

⑦个别规格(产品目录以CC标示)

包装方式(载带包装 1000/ 3000/ 15000个/ 卷盘)

■规格

| 项目 | 记号 | 标准规格 | 单位 | 备注 |
|--------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 频率 | f _{nom} | 16000 ~ 60000 | kHz | |
| 泛音次数 | OT | Fundamental | - | |
| 负载容量 | CL | 8 | pF | 其他负载容量, 敬请咨询。 |
| 频率容差 | f _{tol} | ±15 | ×10 ⁻⁶ | 25°C±3°C |
| 串联电阻 | R1 | Table 1 | ohm | |
| 激励级 | DL | Table 2 | μW | |
| 工作温度范围 | T _{use} | -10 ~ +70 | °C | -30 ~ +85 |
| 储存温度范围 | T _{stg} | -40 ~ +85 | °C | |
| 频率温度特性 | f _{tem} | ±15 | ×10 ⁻⁶ | 对于25°C频率的偏差 |

以上规格为规格示例, 如需其他规格, 敬请咨询。

■Table1 串联电阻

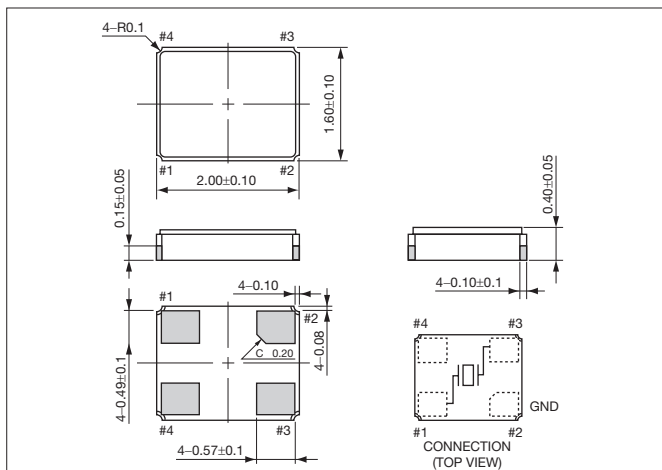
| 频率范围 | 串联电阻 |
|-------------------------------------|-----------|
| 16000 ≤ f _{nom} < 18000kHz | 200Ω max. |
| 18000 ≤ f _{nom} < 26000kHz | 150Ω max. |
| 26000 ≤ f _{nom} < 40000kHz | 60Ω max. |
| 40000 ≤ f _{nom} ≤ 60000kHz | 50Ω max. |

■Table2 激励级

| 频率范围 | 激励级 |
|-------------------------------------|-------------------|
| 16000 ≤ f _{nom} ≤ 60000kHz | 10μW (100μW max.) |

■外形尺寸

(单位: mm)



■推荐焊盘图案

(单位: mm)

